



证券代码：300567

证券简称：精测电子

编号：2026-004

武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	线上参与精测电子 2025 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-17:00
地点	“投关易”小程序
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：彭骞先生 独立董事：张慧德女士 董事、副总经理、董事会秘书：刘炳华先生 财务负责人：游丽娟女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：半导体业务高增长、高毛利，请问国产替代进度和 2026 年订单目标如何？</p> <p>A：2025 年，公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，进一步加大对先进制程领域（28nm 以下）的研发投入与产品布局。随着前期高强度研发投入逐步进入业绩兑现阶段，公司技术产业化进程全面提速，半导体领域主营产品均实现规模化量产，交付能力大幅增强，收入确认规模同比显著增长。与此同时，公司持续优化业务结构、提升经营效率，推动半导体板块盈利能力显著改善，新签订单、营业收入、净利润均实现同比大幅增长。报告期内公司在整个半导体板块实现销售收入 131,777.32 万元，较上年同期增长 71.60%；归母净利润 11,222.06 万元，成功实现扭亏为</p>



盈，归母净利润较上年同期增加 14,262.68 万元；公司在半导体领域毛利率为 49.65%，较上年同期上升 3.90 个百分点。截至《2025 年年度报告》披露日，公司在半导体领域在手订单约 25.33 亿元，占公司整体订单近 60%。半导体领域已成为公司经营业绩的核心支撑。

2026 年，公司将进一步聚焦半导体等优势领域，不断加大对先进制程领域（28nm 及以下）的研发投入，膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备等核心主力产品持续放量，另外公司积极推进明场光学缺陷检测设备、无图形暗场缺陷检测设备、有图形暗场缺陷检测设备等先进制程新产品的研发布局，推动半导体板块快速发展。

Q2：公司扣非盈利偏弱，请问盈利质量不高的主要原因是什么？后续如何改善？

A：公司属于技术密集型的科技企业，员工平均薪资及相关费用较高致使费用水平较高，联营企业处于快速投入期，其亏损对公司经营业绩形成一定拖累后续公司将针对性优化调整整体业务结构，集中资源聚焦半导体等核心优势领域，聚力做强主业，进一步提升整体经营效益。

Q3：目前大额在手订单充裕，交付节奏和收入确认进度如何安排？

A：公司签订的半导体前道量检测设备订单，交付周期按行业惯例及合同约定执行。半导体检测设备的交付周期普遍在 6 个月以上，国外厂商的交付周期一般长达 12 个月以上。随着公司在半导体领域技术水平的不断提高，公司半导体检测设备交付周期有望进一步缩短。

Q4：三大业务毛利率分化明显，新能源业务何时扭亏、有哪些整改措施？

A：报告期内，公司新能源业务仍面临亏损的压力与挑战，新能源领域实现销售收入 16,883.13 万元，较上年同比增长



1.09%；归母净利润亏损 8,586.25 万元，相较于去年同期亏损同比增加 50.29%；公司在新能源领域毛利率为 27.41%，较上年同期下降 3.40 个百分点。针对新能源领域持续亏损的不利局面，公司持续优化业务结构，并对管理团队进行调整，已取得积极效果，截至《2025 年年度报告》披露日，公司在新能源领域在手订单约 7.19 亿元。

Q5：请问公司先进封装业务布局进展如何，与主业协同及业绩贡献时点在哪？

A：公司目前在半导体领域的主营产品分为前道量检测设备、后道电测检测设备、先进封装量检测设备和核心器件等。随着先进封装装备技术快速迭代，部分前道工艺向封装环节延伸，拉动半导体前道量检测、刻蚀、薄膜沉积、键合等设备的需求。面对 2.5D/3D 等先进封装挑战，公司现有前道量检测设备（主要包括膜厚系列产品、OCD 设备、电子束设备、明场光学缺陷检测设备等核心产品）已全部导入先进封装产线。

公司于 2024 年 3 月通过投资湖北星辰深度布局半导体先进封装领域，目前湖北星辰已建成国内领先的 12 英寸集成电路先进封装研发线，核心工艺已全面贯通，正在进行客户导入与小批量生产，可为客户提供一站式先进封装成套解决方案。湖北星辰已启动量产产线建设，旨在为客户提供充足产能保障。湖北星辰对标国际领先先进封装工艺平台，持续开展技术研发与攻关，已同时具备中、高密度先进封装全套工艺技术，并在互联间距、互联密度、功耗等方面拥有领先优势，可为多类应用场景需求下不同领域客户提供产品定制化解决方案。

Q6：公司资产负债率偏高，有无降杠杆计划，后续融资如何安排？

A：公司目前处于高速发展期，需大量资金支持半导体产业链中的股权扩张及业务拓展。我司将根据实时情况对资产负债率进行观察及调整。



Q7：2025 年营收高增、业绩扭亏，核心驱动是什么？2026 年能否持续增长？

A：2025 年，公司紧抓半导体设备国产化替代的关键窗口期，持续巩固并提升在半导体量检测领域的国内领先地位，进一步加大对先进制程领域（28nm 以下）的研发投入与产品布局。随着前期高强度研发投入逐步进入业绩兑现阶段，公司技术产业化进程全面提速，半导体领域主营产品均实现规模化量产，交付能力大幅增强，收入确认规模同比显著增长。与此同时，公司持续优化业务结构、提升经营效率，推动半导体板块盈利能力显著改善，新签订单、营业收入、净利润均实现同比大幅增长。在平板显示业务方面，2025 年行业复苏态势持续延续，终端应用需求稳步回暖，受益于 LCD 大尺寸及超大尺寸产能扩张、国内头部客户 G8.6 代生产线投建，以及 OLED 领域资本开支上行，行业检测设备需求景气度持续走高。报告期内，公司平板显示检测业务实现快速增长，叠加客户结构与产品结构的持续优化，业务毛利率明显提升，盈利能力显著增强。2026 年，公司将进一步聚焦半导体等优势领域，不断加大对先进制程领域（28nm 及以下）的研发投入，积极推进明场光学缺陷检测设备、无图形暗场缺陷检测设备、有图形暗场缺陷检测设备等先进制程新产品的研发布局。在平板显示领域巩固已有技术优势，进一步加大对新型显示以及智能和精密光学仪器领域的研发投入，积极向上下游领域进行延展，保持竞争力；在新能源领域，公司持续优化业务结构，并对管理团队进行调整，依托产品技术创新突破，推动新能源板块协同发展。

Q8：各项费用持续增长，后续费用如何管控，2026 年费用率目标是多少？

A：目前公司半导体板块处于高速发展期，对各项费用及人才需求增加迅猛，后续公司将优化薪酬结构，提升人效，实现精细化管理以控制各项费用率。



	<p>Q9：显示业务迎来复苏，2026 年海内外市场拓展及毛利提升空间多大？</p> <p>A：公司是国内平板显示检测设备领域的龙头企业，在全球显示检测行业处于第一梯队。公司产品覆盖 LCD、OLED、MicroOLED、Mini/Micro-LED 全制程检测设备，深度配套三星、LG、Apple、Meta 等海外头部客户。公司深耕 AR/VR 领域，聚焦海外头部客户核心需求，依托精密仪器至光学检测系统全链条自主开发能力，构建起一站式全流程检测服务体系，为海外头部客户提供定制化、高可靠性的检测解决方案。公司凭借自主研发的核心技术优势，在海外 Top 客户的 VR 项目 MicroOLED 微显示、AR 项目 DisplayEngine 光引擎、Eyepiece 目镜模组及 FATP 整机组装制程检测等关键环节检测项目中深度合作，持续收获订单，彰显一站式自主服务核心竞争力，进一步巩固海外 AR/VR 检测领域市场地位，为业务全球化布局奠定坚实基础。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026 年 5 月 8 日